

2009年半导体设备行业研究报告



半导体设备行业的波动范围惊人。2005-2007年NAND闪存崭露头角，出货量呈几何级数增加，厂家在NAND领域豪掷千金。再有是新兴的DDR2，微软曾经操作系统Vista都被认为可以大幅度促进DDR2的出货量。晶圆代工领域则展开先进制程竞赛，大家纷纷向90纳米、65纳米挺进，半导体设备自然出货量激增。封测领域，FC、CSP、WLP等新封装形式的出现也对设备行业有很大的提升作用。2005-2007年透支了半导体行业的发展空间，不少厂家的收入翻倍，当大家都沉浸在美梦中时，半导体设备行业开始大幅度下滑。

2008年的下滑还只是个开始，2009年的下滑幅度非常大，几乎所有的厂家都无法达到2007收入的50%，甚至20%。特别是半导体设备的前段（Front-end）领域像光刻行业，NIKON和CANON分别排名第二第三，排名第一的ASML下滑了大约44%，NIKON则下滑了73%，CANON下滑了84%。几乎所有的厂家都出现了亏损。

半导体设备后段的厂家则稍微好些，特别是测试领域，下滑幅度不太大。

否极泰来，2009年下半年行业复苏的迹象已经出现，尤其是内存领域。内存领域是半导体设备最大的市场。IDM领域，英特尔依然是半导体设备最大的客户。不过半导体设备行业缺乏杀手级应用，缺乏革命性的产品和技术，2005-2007年的高速增长恐怕再也无法出现。

	2007	2008	2009	2009年运营利润率
Applied Material	6788	4088	2008	7.8%
ASMI	4809	3525	1960	-8.5%
Tokyo Electron	5362	3453	1558	21.0%
KLA-Tencor	2326	1771	1520	-38.0%
Lam Research	2245	1502	1116	25.2%
Nikon	1806	1333	488	-23.6%
Carl Zeiss SMT	1208	1314	1068	10%
Dainippon Screen	1196	832	746	
Teradyne	707	825	728	-21.7%
Advantest	1608	788	340	-37.7%
ASM International	1023	787	519	-24.7%
Hitachi High-technologies	960	711	688	-24.0%
Novellus system	1200	703	398	-19.4%
Canon	784	608	98	
Varian	863	491	362	-11.9%
Verigy	633	464	336	-32.7%
Daifuku	335	402	138	
Aixtron	261	366	349	13.2%
Hitachi Kokusai Electric	618	361	178	-17.4%
Tokyo Semitsu	568	334	128	

2007-2009年全球20大半导体厂家收入排名 单位：百万美元

报告目录

第一章：半导体产业现状

- 1.1、半导体产业近况
- 1.2、半导体设备简介
- 1.3、EUV对ArF
- 1.4、15英寸晶圆

第二章：半导体设备产业与市场

- 2.1、整体半导体设备市场
- 2.2、晶圆厂半导体设备市场
- 2.3、全球半导体市场地域分布

第三章：半导体设备产业

- 3.1、半导体设备产业概述
- 3.2、半导体产业地域分布
 - 3.2.1、台湾半导体设备市场与产业
 - 3.2.2、中国大陆半导体设备市场与产业
- 3.3、自动测试
- 3.4、蚀刻

第四章、半导体设备下游市场分析

4.1、晶圆代工工业

- 4.1.1、晶圆代工工业现状
- 4.1.2、晶圆代工厂资本支出
- 4.1.3、GlobalFoundries
- 4.1.4、TSMC
- 4.1.5、联电
- 4.1.6、SMIC

4.2、内存产业

- 4.2.1、NAND产业现状
- 4.2.2、东芝
- 4.2.4、DRAM产业现状
- 4.2.5、HYNIX与三星制程进度
- 4.2.6、DRAM厂家2010年支出
- 4.3、IDM
- 4.4、封测产业

第五章、半导体设备厂家研究

- 5.1、应用材料 (Applied Materials)
- 5.2、ASML
- 5.3、KLA-Tencor
- 5.4、日立高科
- 5.5、TEL
- 5.6、NIKON

5.7、DNS

5.8、AIXTRON

5.9、ADVANTEST

5.10、LamResearch

5.11、Zeiss SMT

5.12、Teradyne

5.13、Novellus

5.14、Verigy

5.15、Varian

5.16、日立国际电气

5.17、ASM国际

5.18、佳能

图表目录

- 1997年1月-2009年7月全球半导体订单与出货比
- 2007年1月-2009年9月北美半导体厂家订单与出货比
- IC设计产业链
- 晶圆制造流程图
- 2006-2012年全球半导体设备市场规模
- 1987-2010年全球半导体设备资本支出统计及预测
- 1987-2010年全球半导体材料收入统计及预测
- 2008年1季度-2010年4季度全球晶圆厂建设投入统计及预测
- 2008年1季度-2010年4季度全球晶圆厂设备投入统计及预测
- 2008年1季度-2010年4季度全球晶圆厂投入统计及预测
- 1998-2010年全球折合8英寸晶圆产能下游产品类型分布
- 2008年1季度-2010年4季度全球晶圆厂产能分布统计及预测
- 2008年全球半导体设备市场地域分布
- 2009、2010年全球半导体市场地域分布预测
- 2007-2010年全球半导体设备市场技术分布
- 2009-2010年全球半导体市场下游应用分布
- 2008、2009年全球晶圆厂材料市场规模与地域分布
- 2008、2009年全球封装厂材料市场规模与地域分布
- 2009年半导体设备产业产值分布
- 2009年半导体产业产值地域分布
- 2008年台湾半导体设备市场按技术分布
- 2008年台湾半导体设备进口金额国别分布
- 2009年全球半导体ATE市场下游应用分布

- 2009年全球半导体ATE市场地域分布
- 2007年全球自动测试主要厂家市场占有率
- 2008年全球自动测试厂家市场占有率
- 2005-2008年半导体蚀刻设备市场主要厂家市场占有率
- 2004年1季度-2010年4季度晶圆厂产能利用率统计及预测
- 2008年1季度-2010年4季度晶圆代工行业收入统计及预测
- 2007-2012年全球主要晶圆代工厂产能统计及预测
- 2003-2009年TSMC收入与运营利润率统计及预测
- 2007年季度-2009年3季度TSMC收入与运营利润率统计
- 2007年1季度-2009年3季度TSMC收入制程分布 (Revenue by node)
- 2000-2009年UMC收入与运营利润率统计及预测
- 2007年4季度-2009年3季度UMC收入制程分布
- 2006年1季度-2009年4季度UMC产能变化
- 2003-2009年中芯国际收入与运营利润率统计及预测
- 2007年1季度-2009年3季度中芯国际收入制程分布 (Revenue by node)
- 2005-2013年NAND、DRAM企业资本支出统计及预测
- 2008年11月-2009年11月16、32Gb 4GX8 MLC型NAND价格走势
- 2009年2季度-2010年3季度东芝NAND制程分布
- 2008年4季度-2011年1季度全球DRAM厂家进入DDR3 时间
- 2009年2季度-2010年3季度HYNIX DRAM制程分布
- 2009年2季度-2010年3季度HYNIX NAND制程分布
- 2009年2季度-2010年3季度三星DRAM制程分布
- 2009年2季度-2010年3季度三星NAND制程分布
- 2004-2009财年应用材料收入与毛利率统计
- 2006-2009财年应用材料销售额部门分布

- 2009财年1季度-2009财年4季度应用材料销售额与运营利润统计
- 2009财年4季度应用材料收入部门分布
- 2009财年4季度应用材料订单地域分布
- 2006-2009财年前9月应用材料订单金额地域分布
- 2006-2009财年前9月应用材料销售额地域分布
- 2006-2009财年前9月应用材料订单金额部门分布
- 2004-2009年ASML收入与运营利润率统计及预测
- 2003-2009年3季度ASML每季度收入
- 2008年1季度-2009年3季度ASML毛利率与运营利润率统计
- 2008年1季度-2009年3季度ASML出货量技术分布
- 2008年1季度-2009年3季度ASML收入地域分布
- 2008年1季度-2009年3季度ASML收入客户分布
- 2008年、2009年前9月Backlog客户分布
- 2008年、2009年前9月Backlog地域分布
- 2007年1月-2009年8月DRAM领域ASML设备产能利用率
- 2007年1月-2009年8月NAND领域ASML设备产能利用率
- 2005-2009财年KLA-Tencor收入与运营利润率统计
- 2007-2009财年KLA-Tencor收入地域分布
- 2009、2010财年日立高科收入部门分布统计与预测
- 2009、2010财年日立高科运营利润部门分布统计与预测
- 2009、2010财年日立高科半导体设备收入产品分布
- 2009、2010财年日立高科半导体设备收入地域分布
- 2001-2010财年TEL收入与运营利润统计
- 2007财年2季度-2010财年2季度TEL收入、运营利润率统计
- 2000年3季度-2009年3季度每季度TEL各部门订单金额统计

- 2009、2010财年上半年TEL收入部门分布
- 2009、2010财年上半年TEL半导体设备收入地域分布
- 2009、2010财年上半年TEL FPD/PVE设备收入地域分布
- 2007年3季度-2009年3季度TEL订单余额统计
- 2007年3季度-2009年3季度TEL订单额地域分布
- 2005年3季度-2009年3季度TEL半导体设备部门定单产品类型分布
- 尼康2004-2010财年收入与运营利润统计及预测
- 2006-2010财年尼康精机收入与运营利润统计及预测
- 2008-2010财年尼康精机曝光机半导体领域销售量技术分布
- 2008-2010财年尼康精机曝光机半导体领域销售量地域分布
- 2008-2010财年尼康精机平板显示领域曝光机销量世代分布
- 2004-2009财年DNS收入与运营利润率
- 2008财年3季度-2010年2季度DNS收入部门分布与运营利润率统计
- 2008财年3季度-2010年2季度DNS定单金额部门分布
- 2007财年4季度-2010财年1季度DNS半导体设备收入下游应用分布
- 2008财年4季度-2010财年2季度DNS平板显示设备收入世代分布
- 2003-2008年AXITRON员工数量统计
- 2009年前9月AIXTRON收入技术分布
- 2009年前9月AIXTRON收入下游分布
- 2006-2009年前9月AIXTRON收入地域分布
- 1999-2009年前9月AIXTRON收入下游分布
- 2003-2010财年ADVENTEST收入与运营利润率统计及预测
- 2006财年3季度-2009财年2季度ADVANTEST收入与订单统计
- 2008财年1季度-2009财年2季度ADVANTEST订单部门分布
- 2008财年1季度-2009财年2季度ADVANTEST订单地域分布

- 2008财年1季度-2009财年2季度ADVANTEST收入部门分布
- 2008财年1季度-2009财年2季度ADVANTEST收入地域分布
- 2008财年1季度-2009财年2季度ADVANTEST支出分布
- 2005-2009财年LamResearch收入与运营利润统计
- 2007-2009财年LamResearch收入地域分布
- 2004-2008财年Zeiss SMT收入与客户分布
- 2004-2009泰瑞达收入与运营利润统计
- 2006-2008泰瑞达订单地域分布
- 2006-2008泰瑞达收入地域分布
- 2004-2009年Verigy收入与运营利润 统计及预测
- 2006-2008年Verigy收入地域分布
- 2005年1季度-2009年3季度Verigy收入下游分布
- 2004-2009财年Varian收入与运营利润统计
- 2006-2009财年Varian收入业务类型分布
- 2006-2008财年Varian收入地域分布
- 2006-2008财年Varian收入下游应用分布
- 2005-2009财年日立国际电气收入与运营利润统计
- 2007-2009财年日立国际电气各部门收入统计
- 2006-2009年ASM前后端收入统计
- 2004-2009年ASM收入与运营利润统计及预测
- 2006-2008年ASM前段（Front-End）设备收入地域分布
- 2006-2008年ASM后段（Back-End）设备收入国别分布
- 1999-2009财年佳能收入与净利润统计及预测
- 1999-2008财年佳能收入产品分布
- 2007-2009年全球20大半导体厂家收入排名

- 2009年1季度全球晶圆代工厂家排名
- 2007年1季度-2009年4季度全球主要晶圆代工厂支出统计及预测
- 2008年1季度-2009年4季度TSMC产能变化
- 联电主要转投资公司一览
- 中芯国际晶圆厂简介
- 2009年2、3季度全球NAND厂家营收统计
- 2009年3季度全球DRAM内存厂家排名
- 2008年1季度-2009年8月台湾内存厂家收入统计
- 2008年1季度-2009年4季度台湾内存厂家晶圆产量
- 2010年全球主要DRAM厂家支出预测
- 2009年1季度-2009年3季度全球20大半导体公司排名
- 2008-2009年全球半导体企业资本支出前20家排名
- 2009年全球19家IC陷阱封装厂家收入预测
- ASML现役产品一览
- KLA-Tencor产品一览
- ASM国际ALD、CVD产品一览
- ASM国际封装用设备一览
- ASM各领域研发人员数量与业务部门所在地
- ASM各基地简介

购买报告

价 格	电子版： 8000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 7500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 165页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-06		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511098.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。